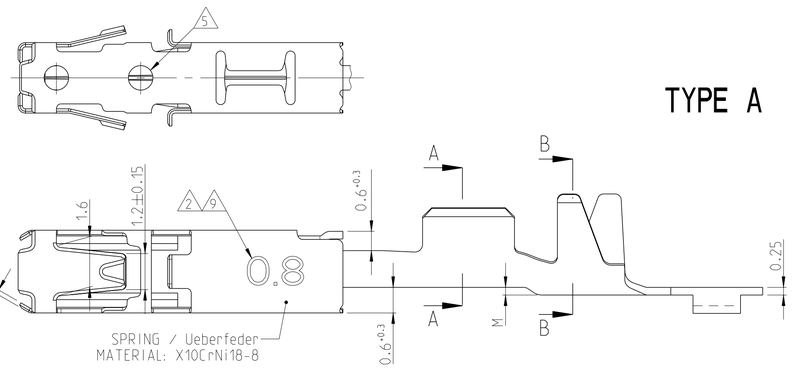
THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION 2003
© COPYRIGHT 2003 Tyco Electronics AMP GmbH ALL RIGHTS RESERVED.

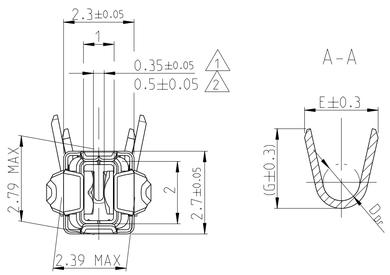
LOC	DIST
A1	-

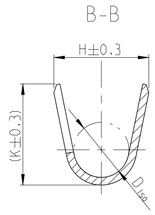
REVISIONS

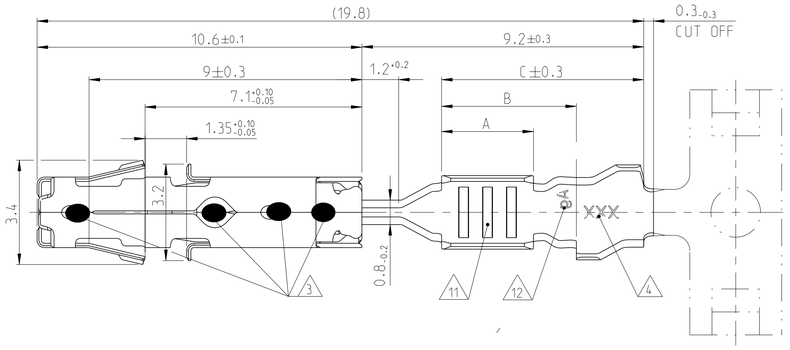
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	B18	SWS table remove; Note 7 extended	22APR2016	Abr	Beck
	B19	1241376-2 OBSOLETE. INSUL. DIA MODIFIED	04AUG2016	MAH.	BECK
	B20	CRIMP DIMENSIONS CHANGE	16NOV2016	HO.	BECK
	B21	New Silver PN´s added	17AUG2017	FRAN	BECK

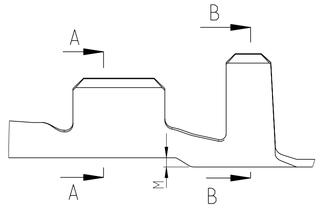
TYPE A

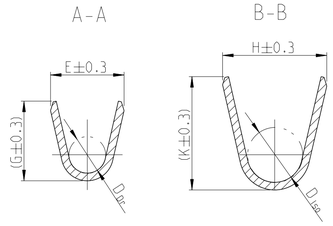


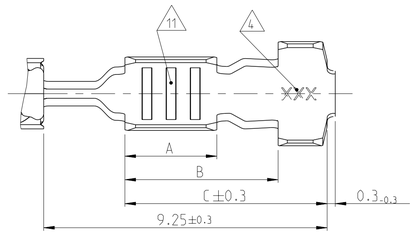






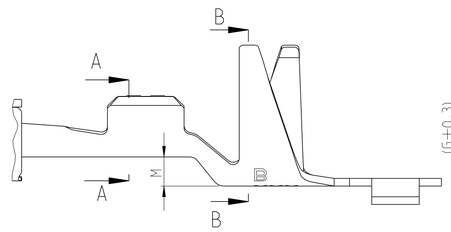


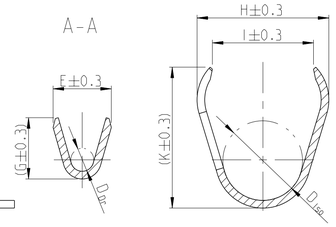


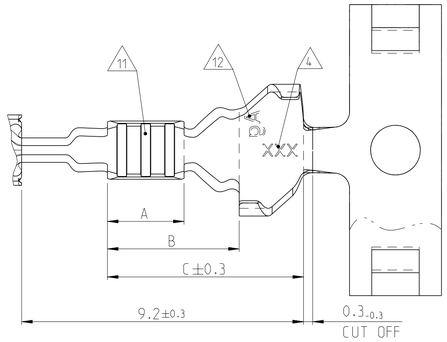


TYPE B

SINGLE WIRE SEALING SYSTEM △7







ORDER NO. Bestell-Nr. Strip Bandware	REV.	TO BE USED ON TAB Geeignet fuer Flachstecker	WIRE RANGE Drahtgroessenbereich (mm²)	INSULATION DIA Isolations Ø (mm)	MATERIAL Werkstoff	PLATING Ueberzug	LENGTH Laenge	WIRE CRIMP Drahtcrimp	INSUL. CRIMP Isol.-Crimp	
							CRIMP DIMENSIONS (mm) Crimpabmessungen			
1718558-1	B	△2	>1.0...1.5 △8	1.9...2.4	CuNiSi	TINPLATED vorverzinnt	A = 3.0 B = 4.5 C = 6.6	E = 2.7 G = (2.9) D_{Dr} = 1.4	H = 4.5 I = 3.6 K = (4.9) D_{Iso} = 2.9 M = 0.9	SINGLE WIRE SEALING SYSTEM Einzeldichtungssystem △7
1418884-3	B	△1			CuNiSi	PRESILVER vorversilbert				
1418884-1	B				CuNiSi	TINPLATED vorverzinnt				
1534162-1	B	△2	0.5...1.0	1.4...2.1	CuNiSi	TINPLATED vorverzinnt	A = 3.0 B = 4.7 C = 6.8	E = 2.4 G = (2.6) D_{Dr} = 1.2	H = 4.3 I = 3.3 K = (4.8) D_{Iso} = 2.7 M = 0.9	
1-1241380-2	B	△1			CuNiSi	△10				
1241380-3	B				CuNiSi	PRESILVER vorversilbert				
1241380-2	B				CuNiSi	△5				
1241380-1	B				CuNiSi	TINPLATED vorverzinnt				
1564324-3	B	△1	0.2...0.35	1.1...1.4	CuNiSi	PRESILVER vorversilbert	A = 2.5 B = 4.3 C = 6.3	E = 1.9 G = (2.0) D_{Dr} = 0.75	H = 4.3 I = 3.3 K = (4.8) D_{Iso} = 2.6 M = 0.9	
1564324-2	B				CuNiSi	△5				
1564324-1	B				CuNiSi	TINPLATED vorverzinnt				
1534160-1	B	△2			CuNiSi	TINPLATED vorverzinnt		E = 1.8 G = (1.7) D_{Dr} = 0.75		
1241378-3 △13	B	△1			CuNiSi	PRESILVER vorversilbert				
1241378-2 △13	B				CuNiSi	△5				
1241378-1 △13	B				CuNiSi	TINPLATED vorverzinnt				
1241376-3 (B21)	A	△1	0.5...1.0 △6	MAX. 2 x 1.6 △6	CuNiSi	PRESILVER vorversilbert	A = 3.0 B = 5.0 C = 6.6	E = 2.4 G = (2.6) D_{Dr} = 1.2	H = 3.4 K = (3.7) D_{Iso} = 1.8 M = 0.3	TYPE B
~~1241376-2~~	B				CuNiSi	△5				
1241376-1	B				CuNiSi	TINPLATED vorverzinnt				
1418410-1	B	△2	1.5 △8	2.2...2.4	CuNiSi	TINPLATED vorverzinnt	A = 3.2 B = 4.4 C = 6.6	E = 2.7 G = (2.9) D_{Dr} = 1.4	H = 3.9 K = (3.9) D_{Iso} = 1.9 M = 0.2	TYPE A
1534334-3 (B21)	A	△1			CuNiSi	PRESILVER vorversilbert				
1534334-1	B				CuNiSi	TINPLATED vorverzinnt				
1418408-1	B	△2	0.5...1.0	1.4...2.1	CuNiSi	TINPLATED vorverzinnt	A = 3.0 B = 4.4 C = 6.6	E = 2.4 G = (2.6) D_{Dr} = 1.2	H = 3.1 K = (3.3) D_{Iso} = 1.8 M = 0.2	
1241374-3	B	△1			CuNiSi	PRESILVER vorversilbert				
1241374-2	B				CuNiSi	△5				
1241374-1	B				CuNiSi	TINPLATED vorverzinnt				
1564980-3 (B21)	A	△1	0.2...0.35	1.1...1.4	CuNiSi	PRESILVER vorversilbert	A = 2.5 B = 3.7 C = 5.7	E = 1.9 G = (2.0) D_{Dr} = 0.75	H = 2.3 K = (2.3) D_{Iso} = 1.1 M = 0	
1564980-2	B				CuNiSi	△5				
1564980-1	B				CuNiSi	TINPLATED vorverzinnt				
1241372-2 △13	B	△1			CuNiSi	△5		E = 1.8 G = (1.7) D_{Dr} = 0.75		
1241372-1 △13	B				CuNiSi	TINPLATED vorverzinnt				

FORM OF ISOLCRIMP Form des Isol-Crimp

4805 (3/11)

Bemerkungen
NOTES

△1 Geeignet fuer Flachstecker 1.5 +0.2 -0.1 x 0.6 +0.07 -0.03
TO BE USED ON TAB

△2 Geeignet fuer Flachstecker 1.5 +0.2 -0.1 x 0.8±0.03
TO BE USED ON TAB

△3 Laserschweissung
LASERWELDED

△4 Kennung fuer Werkzeug und Revisionsstand
DIE-IDENTIFICATION AND REVISION STATUS

△5 Min. 0.8µm Goldueberzug im Kontaktbereich ueber min. 1.3µm Nickelueberzug; min. 1µm Zinnueberzug im Crimpbereich. Zur Kennzeichnung siehe Loch an der Ueberfeder
MIN. 0.8µm GOLDPLATE IN CONTACT AREA OVER MIN. 1.3µm NICKELPLATE; MIN. 1µm TINPLATE IN CRIMP AREA. AS INDEX SEE HOLE AT SPRING

△6 Fuer Doppel- und Einzelcrimp
FOR DOUBLE AND SINGLE CRIMP

△7 Auswahl der Einzeldichtung entsprechend dem Isolationsdurchmesser nach Verarbeitungsspezifikation 114-18386
SINGLE WIRE SEAL TO BE SELECTED ACCORDING TO INSULATION-DIA ACCORDING TO APPLICATION SPECIFICATION 114-18386

△8 Zulaessige Strombelastbarkeit siehe Drahtgroesse 1 mm²
CURRENT CARRYING CAPABILITY SEE WIRE CROSS SECTION

△9 Kennzeichnung fuer besonderes Oeffnungsmass und Tab-Abmessung 0.8mm.
SIGNED FOR SPECIAL GAPSIZE AND TABDIMENSION 0.8mm.

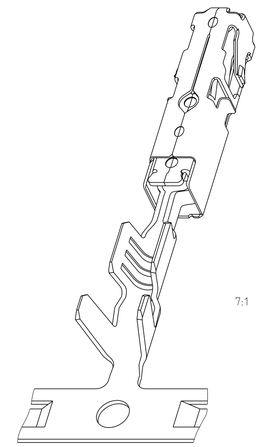
△10 1.27µm Goldueberzug im Kontaktbereich ueber min. 1.3µm Nickelueberzug; min. 1µm Zinnueberzug im Crimpbereich. Zur Kennzeichnung siehe Loch an der Ueberfeder

△11 Unterschiedliche Ausfuehrung und Anzahl der Rillen moeglich
DIFFERENT FORM AND NUMBER OF THE SERRATION POSSIBLE

△12 Kennzeichnung mit "Ag" bei Silberueberzug im Kontaktbereich
MARKING WITH "Ag" FOR SILVERPLATING IN CONTACT AREA

△13 1241372 nicht fuer Neuanwendung, wird ersetzt durch 1564980
1241378 nicht fuer Neuanwendung, wird ersetzt durch 1564324
1241372 SUPERSEDED BY PN 1564980
1241378 SUPERSEDED BY PN 1564324.

14 Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller ueberlassen
DETAILS OF DESIGN ARE LEFT TO MANUFACTURER



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 1 PLC ±0.2; 2 PLC ±; 3 PLC ±; 4 PLC ±; ANGLES ±1°

MATERIAL SEE TABLE siehe Tabelle

FINISH SEE TABLE siehe Tabelle

DWN R. Liebing 27AUG2004
CHK A. Mairoser 30JAN2012
APVD M. Bleicher 30JAN2012
PRODUCT SPEC 108-18716
APPLICATION SPEC 114-18386
WEIGHT -

TE Connectivity

NAME AMP MCP 1.5K PRODUCT GROUP DRAWING

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
A1	00779	C-1241436	-

CUSTOMER DRAWING | SCALE 10:1 | SHEET 1 OF 1 | REV B21

Общество с ограниченной ответственностью «МосЧип» ИНН 7719860671 / КПП 771901001
Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

http://moschip.ru/get-element

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:
moschip.ru
moschip.ru_4
moschip.ru_6
moschip.ru_9